|  |
| --- |
| IC先進封裝技術與製程**(網路課程)** |

**課程設計概念:**

在半導體製造技術到達Moore’s Law的經濟極限時，先進封裝可以較低成本方式超越Moore’s Law以提高I/O 密度與執行速度。近幾年來在龍頭Fab和封測廠投入超過百億美元用於先進封裝的技術研發、設備採購和基礎建置。因此先進封裝將大顯身手，半導體從業人員不可不知。

本課程之規劃，為因應封裝業界人才及技術的需求趨勢，由先進封裝之演進和其相關技術、主要材料、製程及終端應用做整體性的探討。讓學員得以了解先進技術、迅速觸類旁通，應用於產品。

**課程對象：**

* 半導體封裝研發、製程、品保或維護工程師，欲了解先進封裝相關製程知識與技術並了解終端應用，以迅速跟進先進封裝潮流、提升或發展主流技術。
* 半導體製造業產業鏈中封裝上下游行業公司之產品研發、外包、工程、行銷、品管人員、專案管理人員等了解先進封裝技術與應用，可與本業產品相互配合得到更高效之產品。
* 欲進入半導體電子產業之理工科系之應屆畢業學生。

大專以上理工背景之從業人員欲培養第二專長，為就業或轉職厚植實力，有志於向半導體製造、封測、電子產業發展者。

**課程大綱 :**

(一).先進封裝技術與基礎製程

1. 定義

2. 關鍵技術 : Bumping、RDL、TSV、Chip on Wafer (CoW)、Wafer On Wafer (WoW)、Hybrid Bond

3. 相關之基礎封裝形式與製程: (1).覆晶(Flip Chip)，(2).晶圓級封裝(WLCSP)，(3).扇出型封裝(FOWLP/FOPLP)及FCCSP/FOWLP/FOPLP 比較

(二).先進封裝技術之緣起和推手

1. 市場及終端應用

2. Moore’s Law，More Than Moore，Chiplets (小晶片)

(三).先進封裝之再進化與異質整合

(四).先進封裝主要材料BT 與 ABF，

(五).終端應用 : 5G/AiP/CIS/AP/Sensor/

(六).半導體產業鏈、角色及市場趨勢

**講師 :** 楊老師

學歷：中央大學機械研究碩士

經歷 : 曾任職Amkor Technology Taiwan EVP、日月欣半導體 VP、Motorola Taiwan處長、TRW、台塑、瑞享等，近20年IC封裝相關業界經驗。

專長 : IC封測工程技術、IC封裝自動化實務、問題解決之思維模式與手法、工廠管理。

**✂--------------------------------✂-------------------------------✂**

報名表回傳

**授課時間：網路課程部分，線上安排14天的學習時間，由學員自選開始時間。**

**報名方式: 填妥報名表後，Email至****service@ssi.org.tw** **; 連絡電話03-5723200**

|  |
| --- |
| **IC先進封裝技術與製程(網路課程)** |
| 姓 名\* |  | 性 別 |  | 電 話\* |  |
| 公司/單位\* |  | 部門及職稱\* |  | 行動電話\* |  |
| E-MAIL\* |  |
| 地 址\* |  |
| 學 歷 | □博士 □碩士 □大學 □專科 □其他 科系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 團體報名 | 聯絡人姓名： 電話： E-mail： |
| 訊息來源\* | □SSI網站 | □SME網站 | □Email | □學會電子報 | □學會FB專頁 | □朋友 |
| □亞太教育網 | □104教育網 | □台灣教育網 | □生活科技網 | □其他:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 發票抬頭： | 統一編號： |
| **課程費用** | 課程費用NT$4,000/人 |
| 以上價格不含郵寄與匯款費用 |
| 付款方式ATM轉帳 | 兆豐國際銀行017 新安分行 0206戶名:亞卓國際顧問股份有限公司帳號:020-09-028980 |

**【注意事項】**

* 「**\***」項目請務必填寫，以利行前通知，或聯絡注意事項。
* 為尊重智財權，課程進行中禁止錄音、錄影。
* 費用含教材講義。
* 因學員個人因素，上課前7天後即不得退費，但得轉讓、轉課、或保留。上課前7天以上申請退費，退費時扣除手續費10%。
* 若退費因素為學會課程取消或延課因素，學會負擔退費之手續費。
* 需報帳者，請務必填寫「公司抬頭」及「統一編號」欄，以利開立收據。
* 團報時每人仍需填一份資料，並加註團報聯絡人聯絡資料。